

Q1：wafer cassette 的应用区别与建议！

A1：根据晶圆的制程来看，在晶圆传输方面，通常可以使用 PP，PBT 即可满足；在常温常湿的制程环境里，也可以使用 PP，PBT 材质 cassette，一般建议客户采用 PBT 材质，因为其刚性，尺寸稳定性更加优良。

在铜制程中，建议使用 PEEK cassette，其在高温下（150 度以下）具有抗高硬度，高机械性能，高抗尺寸变形性，低析出性，高耐磨性，高热稳定性等优越性能，可提供一个良好的承载晶圆环境。

在有酸碱清洗剂的环境中，通常我们建议使用 PFA cassette，它具有抗化学性，高硬度，高分子稳定性以及良好的耐磨性，在酸碱环境可以连续长时间工作。

在高温环境中，通常建议使用金属铝材质的 cassette。

Q2：wafer cassette 可以用在其他领域吗？

A2：可以，wafer cassette 除了广泛的应用于半导体制程以外，它还可以应用在 LED 外延片，衬底片制程中，主要有 PP 和 PFA 两种材质的 cassette；在 Solar Cell 的制程中，也用到了 wafer cassette，主要有 PP 和 PVDF 两种材质的 cassette。我公司代理的日本 Dainichi 产品在 LED, Solar Cell 领域也都可以提供相应 cassette 产品。

Q3：哪些设备需要安装独立灭火系统？

A3：在 FM 认证中，不仅包含了对机台材质的要求，例如一些塑料材质的机台就必须安装灭火报警系统；也包含了对使用的化学液体的要求，例如使用异丙醇等易燃液体的机台就必须安装具备灭火功能的系统，而不仅仅是火灾报警系统。

Q4：为什么两台同样的机台使用的灭火系统有时候价格会不一样？

A4：灭火系统的价格取决于

1.钢瓶体积：同样的机台可能负责的制程不同，也使用不同的化学液体，导致防护空间有所不同，因此选用的钢瓶体积会有差异。

2.感应器和喷嘴数量：同上所述由于防护空间的不同，常见的情况是机台某些区域是定制化的，各家甚至各台使用的配件都不相同，因此感应器和喷嘴数量也不同。

3.系统完备性：对于重要或者高危机台而言，安装后备钢瓶可以在火灾相关故障发生后最快的速度恢复生产，而不会因为等待更换钢瓶消耗时间。

Q5: CMP 在什么条件下使用？

A5: 一般来说，在线宽为 350nm 以下半导体芯片制程中会用到化学机械研磨技术

Q6: CMP 研磨液可否应用于 LED 与太阳能芯片研磨，有何区别？

A6: 一般不建议将 CMP 研磨液应用于 LED 与太阳能芯片研磨，因为研磨的对象不同。

CMP 中研磨液通常需要接触几种 film（如 Poly，Oxide，SiN），但 LED 与太阳能芯片往往只需要研磨一种 film。